

世界领先的精密测量解决方案



Proforma™ 300i – 手动晶圆测量工具

Proforma 300i 使用 MTI 专有的快速、准确、可靠的非接触式 PUSH-PULL 电容探头。Proforma 300i 最大可测量直径是 300mm 硅片的厚度, 总厚度变化以及弯曲度。



Proforma™ 300i – 规格说明

	Proforma 300i	Proforma 300Gi	Proforma 300 OEMi ¹
精度 ² :		±0.25 μm	
可重复性 ³ :		±0.25 μm	
分辨率:		0.05 μm	
电压输入 (电压):		100 to 240VAC	
电压输入 (频率):		50 to 60Hz	
电力输入 (功率):		50 W	
使用温度范围:		15 to 40°C	
响应时间:		60ms	客户指定
尺寸(长 x 宽 x 高):		482x330x279 mm	483x388x89 mm
数据接口		RS232, 网口, USB, LCD	RS232, 网口
可支持的材料 ⁴ :			
Si	●	●	●
Ge	●	●	●
InP	●	●	●
GaAs		●	
重量:	12.3 kg	12.4 kg	5.9 kg



通过计算机存取记录数据



远程进行设定

可选 SEMI MF534-0707 弓形硅片环。

弓形硅片环使得仪器不仅可以测量弯曲度, 同时也能减少了硅片和台面的接触, 给硅片更多的保护

1 OEM 型号只有数据采集系统和探头, 因此, 产品参数将依赖于客户安装的参数, 联系我们确定产品的应用以及预期能达到的功能。

2 在 22°C 恒定的温度下。

3 在重复定位的限定内。

4 测量的能力取决于几个因素 (如电阻率)。

振联科技有限公司
深圳宝安13区宝民一路宝通大厦805-806 室
电话: 0755-27809908
传真: 0755-27809008
EMAIL: santek@santek.com.cn
网址: www.santektech.com

mti instruments